

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度预案》，现将具体情况公告如下：

一、向银行申请授信额度

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，提高资金使用效率，同意公司及子公司（包括现有纳入合并报表范围的各级控股子公司）2026 年度向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 18 亿元。在此额度范围内，公司及子公司（包括现有纳入合并报表范围的各级控股子公司）根据实际资金需求进行长期借款、短期流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。

二、决议有效期

此次授信有效期为本议案自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。上述额度在有效期内可以循环使用。

三、董事会对具体决策权的授权

综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以公司及子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司及子公司将根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，董事会不再逐笔形成决议。为提高授信工作办理效率，董事会授权公司及子公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

四、审批程序

本事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。本事项尚需提交

公司 2025 年年度股东会审议。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日